

CF-L20_晶粒等級圖案定義對準系統

考核項目清單

V2019/04/01

1. **設備危害認知及危機處理【10%】**
 - 廠務設施二次盤面位置 (power、GN2、CDA、PV)。
 - EMO 位置及使用時機。
 - 緊急連絡電話 7762。
2. **作業前檢查【10%】**
 - 狀態告示牌。
 - 螢幕機台狀態、LED 光源狀態、CDA、PV、N2。
 - 使用紀錄表。
 - Mask holder、wafer chuck、loading frame。
3. **機構功能說明【10%】**
 - 晶圓傳送部：cassette、cassette stage、robot arm、pre-aligner(PA)、light tower、magazine。
 - 曝光機主體：light source、cover、wafer stage、tray、monitor、control panel。
 -
4. **曝光程式內容說明【30%】**
 - 命名法則：學校系所_實驗室名稱_光罩名稱_第 1 層/第 2 層以後。
 - (Ex.: TSRI_litho_mask1_1st 或 NCTU_Linlab_MOS2_2nd)
 - Process、Exposure Mode、Contact Mode、Maskholder、Chuck。
 - Separation、Proximity、Thickn. Mask、Thickn. Substrate、Thickn. Resist。
 - Dose、Exposure Settings、
 - Handling。
 - Misc。
 - Contact Force。
5. **曝光作業操作【30%】**
 - 攜帶自己的樣品/光罩赴試，實機操作於 10 分鐘內完成作業。
 - ADI 工具操作。
6. **設備復歸【10%】**
 - Park tray。
 - 使用紀錄表。